

# DDR2: двойное ускорение

DDR SDRAM сегодня — самый широко используемый тип памяти. Однако данная технология подошла к своему физическому пределу. Ожидается, что границу пропускной способности в 3,2 Гбайт/с уже нынешним летом преодолеет новый тип памяти — DDR2.

ехнология DDR2 в компьютерном мире не является чем-то абсолютно новым: видеокарты класса highend уже сегодня используют память типа DDR2. Она позволяет значительно увеличивать производительность графической системы. Сегодня такого типа видеопамять обозначается как GDDR-2 (G означает Graphics), однако принцип ее работы такой же, как у DDR2. При равных значениях тактовой частоты ядра новая технология позволяет достичь увеличения полосы пропускания в два раза по сравнению с традиционными DDRмодулями (см. блок «Сравнение технологий оперативной памяти»).

## Поиск стандарта: Intel дает импульс

Для того чтобы идея стала реальностью и принесла коммерческий успех, вначале должны быть разработаны спецификации, являющиеся промышленным стандартом для всех без исключения производителей. За разработку стандартов оперативной памяти отвечает Объединенный совет по электронным устройствам — JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Альянс JEDEC объединил в своих рядах около 300 производителей чипсетов и чипов ОЗУ.

Все прекрасно помнят, что процесс стандартизации слегка забуксовал при »



» переходе от DDR333 (РС2700) к следующей спецификации. Тогда лидер по производству чипсетов — корпорация Intel решительно противилась введению модулей памяти DDR400/РС3200 и хотела намного раньше вывести на рынок DDR2. В качестве аргументов против DDR400 приводились следующие: быстро изменяющийся уровень сигнала, не поддающиеся учету отражающие свойства сигналов с данными и большие задержки, которые наблюдаются у чипов данного типа.

Лишь после создания собственных чипсетов для DDR400 (i875P и i865) ком-

пания Intel в конце марта 2003 года признала официально спецификацию для DDR400: по сравнению с предыдущим стандартом DDR333 она предусматривает уменьшенные значения тайминга и более высокое напряжение, питающее модули оперативной памяти — 2,6 В вместо прежних 2,5.

Сегодня промышленность опять медлит с переходом на новую технологию памяти. Но поколение DDR закончится с уходом модулей оперативной памяти DDR400 с рынка. Надежная работоспособность более быстрых модулей (типа DDR533/PC3700) не может больше обеспечиваться, поскольку в будущем для них не будет существовать официального стандарта JEDEC.

# **Теория ОЗУ:** как это работает

Чтобы понять проблему ограниченности полосы пропускания DDR-памяти, необходимо слегка углубиться в теорию. Итак, DDR-память использует для передачи данных так называемые Prefetch Bits, то есть предварительно считанные данные, которые требует программа. Такой доступ у DDR-памяти осуществляется по двум конвейерам (Prefetch of 2). Prefetch Bits направляются прямиком на вход І/Обуфера, то есть интегрированного прямо в чип памяти промежуточного буфера. Важно следующее: примерно 90% чипа памяти занимает ядро (называемое также массивом памяти). Массив и І/О-буфер работают на одинаковой частоте.

Из I/О-буфера данные поступают на внешнюю шину памяти, с которой передаются бит за битом. Процесс передачи данных осуществляется по восходящему и нисходящему фронтам тактового импульса. В связи с тем что за один такт передаются два бита, протокол был назван Double Data Rate (DDR), в отличие от прежнего Single Data Rate, или сокращенно SDR. На практике использование DDR-технологии приводит к тому, что работающий на тактовой частоте 133 МГц чип обеспечивает передачу данных с частотой 266 МГц.

Тормозом для технологии DDR является инерционность транзисторов, составляющих массив ОЗУ. В процессе считывания информации нужный массив должен быть полностью очищен и затем снова переписан, в противном случае данные будут потеряны. На это требуется определенное время, вот почему тактовая частота ядра чипа не может безгранично повышаться.

## Память DDR2: меньше значит больше

Как раз в этом и проявляется одна из новаций технологии DDR2. Да, передача данных в модулях DDR2 также осуществляется по методу Double Data Rate, однако различие в том, что у модуля DDR2 буфер I/O работает на частоте, превышающей частоту ядра в два раза. Так, за один такт передается два блока данных, и скорость передачи по сравнению с DDR увеличивается в два раза. Объем буферной памяти в идеале »



» удваивается, а интерфейс связи ядра чипа и І/О-буфера расширяется до четырех конвейеров (Prefetch of 4). Иначе говоря, для достижения той же полосы пропускания, что у DDR-памяти, ядро чипа DDR2 может работать в два раза медленнее.

Преимущество налицо: благодаря меньшим значениям тактовой частоты ядра уменьшается и нагрузка на чип, за счет чего значение питающего напряжения может быть снижено до 1,8 В. Это приводит к уменьшению выделения тепла модулями оперативной памяти. Использование DDR2 позволит в будущем повысить и рабочую частоту ядра чипа — до тех пор, пока можно будет контролировать увеличивающуюся частоту I/O-буфера.

Повышению тактовых частот способствует и уменьшение размера транзисторов. Становятся короче интегрированные в чип проводники, автоматически уменьшается время реакции транзисторов.

## Проблемы с задержками: латентность DDR2

Приведенный выше модельный расчет действителен лишь в идеальном случае: наряду с чистой тактовой частотой ядра памяти реально достижимая пропускная способность зависит еще от так называе-

мой задержки (при ожидании информации, затребованной от накопителя), которая указывает на количество тактов, необходимых для подготовки данных. Вероятность того, что І/О-буфер модулей DDR2 при одиночном доступе будет заполняться по всем имеющимся четырем конвейерам, ниже, чем у DDR SDRAM, имеющей два конвейера. В связи с этим эффективность DDR2 несколько снижается. Вот почему первые модули DDR2 (вероятно, это будут DDR2-400/PC2-3200) продемонстрируют в тестах скорость на 5-10% меньшую, чем их соперники из лагеря DDR400. Этот недостаток через некоторое время будет ликвидирован, поскольку тактовая частота ядра DDR2 быстро возрастет.

#### Быстрее и дешевле

Еще одно преимущество DDR2 заключается в терминации шины — методе согласования нагрузок полному волновому сопротивлению шины передачи данных, при котором устраняются отражения сигнала от физических концов шины.

Дело в том, что на материнской плате с чипсетом для DDR-памяти имеется заземленное сопротивление, которое очищает приходящие на I/O-интерфейсы



▲ Модуль от Micron оснащен контроллером, который управляет режимом терминации

сигналы от помех. Эти помехи (интерференции) возникают в результате того, что каждый сигнал на шине данных отражается соседними компонентами. Чем больше модулей установлено, тем больше вероятность нежелательных отражений. Сопротивления на материнской плате могут подавить интерференции в шине, но полностью устранить их они не в состоянии. Вот почему полоса пропускания по-прежнему остается значительно ниже теоретически возможного уровня.

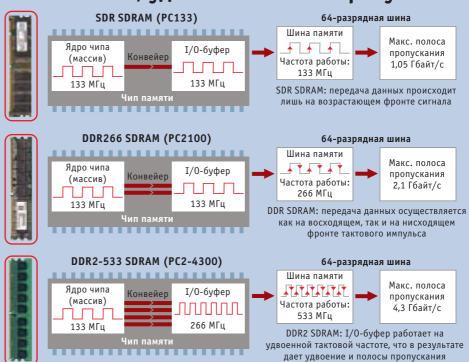
Память DDR2 обходит это препятствие намного элегантнее: сопротивления для »



Сравнение технологий оперативной памяти

# DDR2: одинаковая тактовая частота, удвоенная полоса пропускания

У старой доброй памяти PC133 SDR SDRAM, которую мы знаем со времен процессоров Pentium III, тактовые частоты ядра чипа, І/О-буфера и шины памяти одинаковые. В результате достигается полоса пропускания, равная 1,05 Гбайт/с. Модули DDR266 достигают удвоенного значения. Это происходит из-за того, что несмотря на одинаковые значения тактовой частоты, биты передаются на шину памяти как на восходящем, так и на нисходящем фронте тактового импульса. Это позволяет получить полосу пропускания в 2,1 Гбайт/с. Память DDR2-533 SDRAM (PC2-4300) работает на той же частоте, равной 133 МГц, но благодаря четырем конвейерам упреждающей выборки и удвоенному значению рабочей частоты буфера достигается увеличение полосы пропускания до 4,3 Гбайт/с, что в два раза больше, чем у DDR266, и в четыре раза, чем у РС133.



» терминации размещены прямо на самом модуле. При этом контроллер памяти посылает на шину сигнал, заставляющий все неактивные модули DDR2 переключаться в режим терминации. Поэтому в проводнике остается лишь активный сигнал, что практически полностью исключает интерференцию. Кроме того, материнские платы для DDR2 не так сложны в проектировании и дешевле в разработке.

### На стадии прототипа: DDR2-533

Первым продуктом, выигравшем от введения новой технологии, станет Pentium 4 Prescott. Новый процессор в сочетании с чипсетом, поддерживающим DDR2 (кодовое наименование Grantsdale) позволит получить значительный прирост производительности. Он в состоянии работать с модулями PC2-3200 (DDR2-400) и с PC2-4300 (DDR2-533). Последний вариант был бы идеальным добавлением к Prescott, который Intel намеревается эксплуатировать на частоте системной шины 266 МГц вместо нынешних 200 МГц.

В лабораториях производителей оперативной памяти уже давно работают прототипы стандарта DDR2, а на сайте Intel приведен список рекомендуемых модулей (www.intel.com/technology/memory/ddr/valid/ddr2\_dram\_results.htm). Признанные лидеры данной отрасли (Samsung, Infineon, Micron и Elpida) вовсю работают с утвержденной консорциумом JEDEC в сентябре 2003 года спецификацией DDR2.

# DDR2: Hecobmectumocts c DDR

Для конечного потребителя переход с DDR на DDR2 означает необходимость приобретения новой материнской платы. И хотя по длине модули обоих стандартов одинаковы (около 13,35 см), модуль DDR2 имеет 240 контактов и чисто механически не совместим с обычным DDR-слотом, который предусмотрен для модулей, имеющих 184 контакта. Кроме того, DDR2-модули требуют напряжения 1,8 В, тогда как DDR работают при напряжении 2,5 В.

# **Энергопотребление:** в выигрыше ноутбуки

Ноутбуки выиграют от введения даже первого поколения модулей DDR2 (DDR2-400/PC2-3200): не повышение скорости работы, а снижение энергопотребления делают эту технологию интересной для мобильных компьютеров. Уменьшение питающего оперативную память напряжения позволит продлить время работы аккумулятора в среднем на 6%.

# DDR2-667 появится в этом году

Первые модули оперативной памяти DDR2 (DDR2-400/PC2-3200) обеспечат в лучшем случае такую же производительность, что и нынешние DDR400, но их энергопотребление будет значительно ниже. Реальный прирост производительности ожидается примерно в середине-конце текущего года, когда возрастет внутренняя частота чипов спецификаций DDR2-533 (PC2-4300) и DDR2-667 (PC2-5300). ■■■■

